

~~DESI AVAILABLE UNTIL~~

20239/0202029-US9

PTO/SB/106 (05-00)

Approved for use through: 10/31/02. OMB 0651-0032

Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Declaration and Power of Attorney for Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

私は、以下に記名された発明者として、ここに下記の通り宣言する：

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、郵便の先番をして郵便は、私の氏名の後に記載されたお
りである。

My residence, post office address, and citizenship are as stated
next to my name.

下記の名件の発明について、同許され発明に登録され、且つ特許が
認められている発明本願に属し、私は、最初、最初且つ唯一の発明
者である（唯一の氏名が記載されている場合）か、或いは最初、最初
且つ共同発明者である（複数の氏名が記載されている場合）と断り
いる。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one
name is listed below) or an original, first and joint inventor (if
plural names are listed below) of the subject matter which is
claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

SUBMOUNT AND SEMICONDUCTOR DEVICE

上記発明の詳細説明はここに添付されているが、下記の欄がチェック
されている場合は、この限りでない：

July 30, 2003 の日に提出され、

この出願の米国出願番号またはPCT国際出願番号は、

PCT/JP2003/009706 であり、且つ

この日に修正された図面（該当する場合）

私は、上記の著述文によって考案された、新規請求範囲を含む上記
図面を検討し、且つ内容を理解していることをここに表明する。

私は、既存技術範囲より著述文、うるに充実されている、特許
性について重要な特徴を明示する装置があることを認めめる。

SUBMOUNT AND SEMICONDUCTOR DEVICE

The specification of which is attached hereto unless the
following box is checked:

was filed on July 30, 2003
as United States Application Number or
PCT International Application Number
PCT/JP2003/009706 and was amended on
_____ (if applicable).

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of
the above identified specification, including the claims, as
amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material
to patentability as defined in Title 37, Code of Federal
Regulations, Section 1.56.